

UVA 88E UV 固化封装胶 产品数据表

卓越的可靠性表现

优异的低温固化性能

高良率

简介

UVA 88E 系列为双固化型 UV 粘接/封装胶，专为光学器件封装而设计，适用于 LED、图像传感器(CMOS) 等应用，包括玻璃盖板粘接、镜头粘接等工艺。其中，UVA 88E1 适用于陶瓷或 FR4 基板;UVA 88E2 与 UVA 88E3 为高粘度版本，更适合 LED 应用。UVA 88E1 通常可采用单步 UV 固化工艺，无需后续热固化;而 UVA 88E2 与 A3 可在 UV 光照射下实现快速固化，并可根据需要进行二次热固化。UVA 88E 系列产品不仅对玻璃具有优异的附着力，同时对陶瓷、FR4 等基材也表现出良好的粘接性能。该系列产品适用于高产能、环保型制造环境，在制程速度与可靠性为关键考量因素的应用中表现突出。该材料易于点胶，可有效降低界面应力，并在可靠性(如温度循环性能)方面表现优异，同时具备出色的耐湿性及耐溶剂(FC-40)性能。UVA 88E 系列产品完全兼容无铅焊接工艺。

物理特性

产品名称	UVA 88E 系列粘接剂
外观	无色
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	1.05 g/cc
粘度	6 – 50 kcp
固化后材料性能	
玻璃化转变温度(Tg, TMA)	80 – 135
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha_1 = 65; \alpha_2 = 182$
剪切强度 (FR4 / FR4)	2000 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化条件

UVA 88E 在 365 瓦/英吋、365 奈米波長的紫外線燈(「H」燈)照射下, 光強為 1.5 – 5 瓦/平方公分時, 可在數秒內完成固化。未暴露於紫外光下的組裝电路板的「陰影」區域, 可透過在所需溫度下進行二次熱固化。

热固化工艺

可根据制程需求选择以下热固化条件之一:

110 °C × 30 分钟

120 °C × 15 分钟

150 °C × 5 分钟

储存与保质期

6-9 個月, 前提是物料保存在密封的原容器中, 溫度低於 25 °C。超過此期限的儲存可能會導致黏度升高。請防潮、防蒸發和防止異物進入。蒸發和污染會對這些產品的加工性能產生不利影響。

安全須知

UVA 88E 为一种环保、无毒材料。但在使用和操作过程中，仍建议遵循一般工业卫生规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 SDS (安全数据表)。

包装规格

UVA 88E 黏合劑有售 10 cc 与 30 cc 两种标准包装规格。根据客户需求，亦可提供其他包装形式。如需订购或获取更多信息，请联系 YINCAE。